

ロールtoロール高速レーザー微細穴あけ加工機

高速多孔加工技術で貴社の量産化を支援致します。

従来のガルバノミラーやポリゴンミラーでは実現しえなかった、弊社独自の光学システム **GHS® (Grand Helical Scan)** を搭載したロールtoロールレーザー高速レーザー微細穴あけ加工機の製造・販売を行っております。

GHS® (Grand Helical Scan)

特許取得済

ロール状の薄膜のフィルムや箔を連続的に移送しながら、レーザー光を高速スキャンさせ、微細な孔加工を行う弊社独自の光学システムです。

- ✓ 従来の光学系（ガルバノミラー、ポリゴンミラー）を超越する高速スキャンシステム
- ✓ レーザーパワーロスを極力抑え、1shotで加工を行い連続高速加工を実現
- ✓ 300mm幅までの試作対応設備を保有。量産に向けた加工テストをすぐに実施可能

	GHS@180 (WI-180RR)	GHS@360 (WI-360RR)
原反幅	150mm	300mm
加工幅	120mm	300mm
内径(コア)	76mm(3inch)	
外径	Max : Φ 500mm	
常時速度	0.5~8m/min	0.2~10m/min
搬送速度	MAX 25m/min	MAX 20m/min
テンション	~80N (全幅)	
蛇行精度	\pm 2.0mm以内	



株式会社 ワイヤード

〒955-0861 新潟県三条市北新保2丁目4-15

TEL: 0256-47-1255 / FAX: 0256-47-0930

URL: <https://www.wired.jp.net/>

お問合せ : <http://wired.jp.net/contact/>

